

Datenblatt

CMC TYP	MP 1518-007C
Produktbeschreibung MP 1518-007C ist ein elektrisch isolierender, thermisch leitfähiger, silikonfreier Gap-Filler, mit dem sich gute thermische Anbindungen über große Spaltmaße, z.B. durch Höhenunterschiede elektronischer Bauelemente oder große Toleranzen, erreichen lassen. Das TPE Polymer enthält keine flüchtigen Siloxane, die bei Silikonelastomeren freigesetzt werden. Durch die Formulierung und Füllung des Materials mit Keramikpulver ergibt sich eine hohe thermische Leitfähigkeit. Durch seine extreme Weichheit und Formanpassungsfähigkeit wird ein optimaler thermischer Kontakt schon bei sehr geringem Druck erreicht. Der thermische Gesamtübergangswiderstand wird dadurch minimiert. Durch seine natürliche Haftfähigkeit lässt sich das Material sehr gut vorapplizieren.	
Anwendungsbeispiele Thermische Anbindung von z.B. SMD Bauteilen, Through-hole Vias, RDRAM Speicherbausteine und Bauelementen an Heat Pipes z.B. in Automotiveanwendungen, Notebooks und Industriecomputern.	
Trägermaterial	Silikonfreies TPE mit Keramikfüllung
Farbe	schwarz
Materialstärke in mm	3,0
Härte Shore 00	25
Thermische Eigenschaften	
Thermische Leitfähigkeit in W/(m·K)	1,5
Brennbarkeit UL 94	V0
Betriebstemperaturbereich in °C	-40 bis +120
Elektrische Eigenschaften	
Durchschlagsfestigkeit in KV / mm	> 10
Durchgangswiderstand in Ohm - cm	$1,0 \times 10^{10}$
Sonstige Merkmale	
Silikonfreies TPE	
Extrem weich und formanpassungsfähig	
Vibrationsdämpfend	
Wirkung bei sehr niedrigem Druck	
Leichte Vormontage durch Selbsthaftung (beidseitig selbsthaftend)	

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen.

01/20

Qualitätsgewährleistung: 12 Monate

Technische Änderungen vorbehalten.

Empfohlene Lagerung: keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt, Raumtemperatur < 35°C,
rel. Luftfeuchtigkeit < 85%